

中日半导体行业交流会圆满举行

各位会员，

大家好！

协会 10 月 11 日晚在晶盛机电日本株式会社举行了中日半导体行业交流会，半导体领域的专家学者及数家公司的 CEO 参加，各自介绍了半导体领域的最新技术，现状及未来发展，有几十年做芯片测量与评价的专家介绍了经验与技术，在半导体材料方面值得注目的是用等离子体方法在低温下成功生长出单晶硅外延膜，这比传统方法降低了 4 百多度，还有公司介绍了红宝石，蓝宝石材料的生产研究现状；有几家商贸司介绍了国内半导体设备的需求情况，也有几位 CEO 介绍了他们的投资情况，特别对新材料新技术感兴趣，晶盛公司的陈总介绍了晶盛机电在绍兴的创立发展及在日本设立分公司的情况；另外还在半导体现状及未来发展方面交流了经验及成果，并建立了联系，大家都有同感，交流的很好。

日中半导体行业交流会以后还会举行，欢迎相关行业的和感兴趣的会员关注和联系事务局 (office@casej.jp)。

事务局

